



ICEPT 2025 主要嘉宾

(排名不分先后)

叶甜春 教授	国际欧亚科学院院士、华进半导体董事长、中国半导体行业协会副理事长	陈光雄 先生	中国台湾日月光半导体资深工程副总经理
张建华 教授	中国上海大学 副校长	日暮荣治 教授	日本东北大学
CP.WONG 教授	美国工程院院士、香港科学院院士、中国科学院外籍院士	李国荣 博士	中国北京北方华创微电子装备有限公司第一刻蚀事业单元副总经理
Jeffrey C. Suhling 教授	美国奥本大学教授	叶五毛 博士	拓荆科技股份有限公司高级副总裁
Kees Beenakker 教授	荷兰代尔夫特理工大学、Jiaco Instruments 公司顾问	任潮群	芯慧联芯（江苏）科技有限公司总经理
刘 胜 教授	中国科学院院士、武汉大学教授、IEEE Fellow	母凤文 博士	青禾晶元半导体科技（集团）有限责任公司创始人、CEO
张国旗 教授	荷兰工程院院士、IEEE Fellow	赵 滨	广东星空科技装备有限公司技术总监
刘建影 教授	瑞典皇家工程科学院院士、IEEE Fellow	王俊沙 博士	日本明星大学 主任研究员
刘汉诚 博士	中国台湾欣兴电子公司首席科学家、IEEE Fellow	多喜川 良 博士	日本九州大学副教授
马莒生 教授	IEEE Fellow、清华大学教授、东京大学 Fellow	竹内 魁 博士	日本东北大学助理教授
田中秀治 教授	日本东北大学教授、IEEE Fellow	山口 敦也 博士	JCU 株式会社电子发展部研发中心，日本
Kitty Pearsall 博士	美国 Boss Precision 公司总裁	森川 泰宏 博士	日本爱发科株式会社 经理
Andrew Tay 博士	新加坡国立大学教授、IEEE Fellow、ASME Fellow	Shaw Fong WONG 博士	IEEE EPS R10 项目主席，Intel 公司，马来西亚
菅沼 克昭 教授	日本大阪大学教授	王 谦 博士	IEEE EPS 北京分会主席、清华大学副教授
Tadatomo SUGA 教授	东京大学名誉教授、明星大学教授	James Kim 博士	马来西亚恩智浦半导体 首席工程师
葛维沪 博士	美国 Pacrim Technology 创始人、IEEE Fellow	Shinya Takyu 博士	日本琳得科株式会社 助理总经理
Gu-Sung Kim 教授	韩国江南大学教授	王启东 博士	中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心主任
李宁成 博士	炫纯科技创始人，IEEE Fellow	路秀真 博士	上海大学 微电子学院副院长
吕道强 博士	汉高公司副总裁、IEEE Fellow	Farhang Yazdani 博士	BroadPak 总裁，美国
曹立强 博士	中国科学院微电子研究所副所长	Thiago Moura 博士	Besi 先进封装工艺经理，荷兰
于大全 博士	中国厦门云天半导体科技有限公司创始人，厦门大学教授	René Poelma 博士	Nexperia B.V.高级首席工程师
半那拓 博士	日本爱发科株式会社先进技术研究所 PE 半导体技术研究部总监	陈传彤 博士	大阪大学教授，日本

路国光 博士	电子元器件可靠性技术全国重点实验室副主任，中国	崔成强 博士	广东工业大学教授、佛智芯创始人
Eu Poh Leng 博士	恩智浦半导体高级总监，马来西亚	窦广彬 博士	东南大学首席教授、MEMS 集成电路学科带头人，南京晶芯光电研究院院长
Yik-Yee TAN 博士	Yole 集团首席市场与技术分析师，新加坡	蔡坚 博士	清华大学 教授、集成电路学院党委书记
吴政达 博士	沛顿科技副总经理，中国	黄明亮	大连理工大学材料科学与工程学院 院长、大连理工大学电子封装材料研究所所长
Joonho You 博士	Nexensor 公司 CEO，韩国	杨道国 教授	桂林电子科技大学“电子信息材料与器件教育部工程研究中心”副主任、广西电子封装与组装技术工程研究中心主任
张康 博士	成都奕成科技研发总监，中国	田艳红 博士	哈尔滨工业大学长聘二级教授
蒋岳 博士	伊帕思新材料副总经理，中国	赵凯 博士	华天科技（江苏）有限公司 设计仿真测试总监
杨程 博士	长电科技科学家，中国	王玮 博士	北京大学 长聘教授
孙鹏 博士	华进半导体总经理，中国	杭弢 博士	上海交通大学 教授
王 珺 博士	上海复旦大学教授	刘志权 博士	南方科技大学 教授
Karsten Meier 博士	德累斯顿工业大学副主任，德国	刘丰满 博士	中国科学院微电子研究所 研究员、华进半导体 CTO
霍炎 博士	矽磐微电子（重庆）有限公司电子厂长兼研发总监，中国	张童龙 博士	海思半导体有限公司 高级技术专家
王彧 博士	奇异摩尔集成电路设计有限公司高级设计经理，中国	霍永隽 博士	北京理工大学 材料学院院长聘副教授、博士生导师
奥野敦史	Green Planets CEO，日本	马书英 博士	华天科技 先进封装研究院院长
张晓军 博士	深圳矩阵多元科技董事长，中国	杨晓锋 博士	工业和信息化部电子第五研究所电子元器件可靠性物理及其应用技术实验室 先进封装与微系统可靠性技术总师
苏泳桦	泛林集团板级封装产品事业部全球业务拓展资深总监，中国台湾	秦飞 博士	北京工业大学 电子封装技术与可靠性研究所所长
史洪宾 博士	上海艾为电子技术股份有限公司芯片封装首席专家，中国	汪 贺	芯栋微（上海）半导体技术有限公司创始人/总经理/研发负责人
张靖 博士	贺利氏公司中国 CTO，中国	叶怀宇 博士	南方科技大学 副教授
Daiki Nakaya	Milk 公司创始人兼 CEO，日本	杨连乔 博士	上海大学 新型显示技术及应用集成教育部重点实验室研究员
Sarah Eunkyung Kim	首尔科技大学，韩国	侯召政	华为数字能源技术有限公司 技术与平台规划部部长
Jan Vardaman	Techsearch 总裁，美国	龙浩晖	华为技术有限公司 科学家
杨洋	深圳市华屹超精密测量有限公司研发总监，中国	华佑南 博士	Wintech-nano 副总裁
张国平 博士	深圳先进电子材料国际创新研究院副院长，中国	Thomas Pleschke	EV Group
樊海波 博士	安世半导体首席工程师，中国香港	钟振红	COMSOL 中国技术经理
秦舒阳	苏州模流分析软件有限公司大中华区技术经理，中国	王 楠 博士	上海大学教授
赵毅 博士	珠海硅芯科技有限公司创始人兼首席科学家，中国	殷录桥	上海大学微电子学院研究员
梅云辉 博士	天津工业大学集成电路学院院长，中国	张昱 博士	广东工业大学教授
靳永刚	OIP 科技（新加坡）CEO	陈志文 博士	武汉大学 副教授
鲍华 博士	东南大学教授	肖克来提 博士	中国科学院上海微系统与信息技术研究所 研究员
孙蓉 博士	中国科学院深圳先进技术研究院 先进材料科学与工程研究所所长		

尚金堂 博士	东南大学 电子科学与工程学院教授	陈尊河	苏州科斗精密机械有限公司总经理
孙跃 博士	小米通讯技术有限公司	蒋帅	上海感图网络科技有限公司 CMO
王晨曦 博士	哈尔滨工业大学教授	陈伟岸	北京雅世恒源科技发展有限公司研发经理
李力一 博士	东南大学教授	fa.chuan.chen	MediaTek Inc. Technical Manager
金仁喜 博士	中国科学院微电子研究所研究员	谢业磊	深圳中兴微电子技术有限公司先进封装技术总工
吴蕴雯	上海交通大学副教授	顾锋	苏州微知电子科技有限公司总经理
虎良省	昆明物理研究所	周雅萍	迪思科科技（中国）有限公司副总经理
江 京 博士	天芯互联科技有限公司总经理	周全	苏州天致精工科技有限公司总经理
新隆德	杰希优（深圳）贸易有限公司总经理	胡绍璐	JFSlab 主任工程师
Guangjun Zhang	SCHOTT (Shanghai) Precision Materials & Equipment International Trading Co. Ltd, Senior manager	曾旭	江苏集萃苏科思科技有限公司副总经理
李新芳	江苏正能电子科技有限公司研发总监	何荣基	卫利国际科贸（上海）有限公司董事长
安荣	哈尔滨工业大学副院长	王文阁	卫利国际科贸（上海）有限公司总裁
Fen Chen	Indium, Senior R&D manager	田英	四川航天电子设备研究所技术总监
TANG Qingyuan	Guangdong Fenghua Semiconductor Technology Co., Ltd.Director	Jiaqi Tang	JIACO Instruments, CTO
Liu Bin	AKM MeadvillePackaging Director	Zhengchunbin	Shanghai Fosen Electronics Co.,Ltd., CEO
徐伟	惠州市德赛西威汽车电子有限公司主任工程师	王旭	晟碟信息科技（上海）有限公司, Director
唐彦波	长电科技总监	Keke Zhang	IEIT SYSTEMS CO., LTD, Vice General Manager
汪洋	铜陵富仕三佳机器有限公司研发中心主任	HeYufang	伊帕思新材料总经理
吴斌	上海锡喜材料科技有限公司总经理	郭谦	砺铸智能设备总经理
刘彬云	光华科学技术研究院（广东）有限公司总经理	Liyng ZHENG	NCAP China, Deputy General Manager
褚雨露	浙江奥首材料科技有限公司副总经理（研发总监）	周浩杰	成都雷电微力科技股份有限公司, 部长
黄建斌	浙江宏丰半导体新材料有限公司副总裁	李文龙	沈阳和研, 总经理
田书鼎	浙江宏丰半导体新材料有限公司副总经理	NAKAMURA Atsushi	JX Advanced Metals Corporation, General Manager
游健超	芯力科副总经理	鲁男	深圳市克洛诺斯科技有限公司, 研发副总
潘丽	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司副总经理	吴道伟	西安微电子技术研究所副总工艺师
陈思	上海瑞烯新材料科技有限公司副总经理	李刚	凯戈纳斯总经理
母凤文	青禾晶元半导体科技（集团）有限责任公司创始人兼董事长	Yoshihiko Muraoka	JX Advanced Metals Corporation General Manager
Shinobu Sato	Nitto Boseki Co.. LTD., General Manager	李彦斌	武汉帝尔激光科技股份有限公司销售副总裁
何建锡	元夫半导体副总经理	Steven Sun	SHENZHEN LEADERWE INTELLIGENT, GM
朱卫刚	爱发科商贸总经理	任雪艳	北京鼎材科技有限公司董事长兼总经理
徐朴	深圳市福英达工业技术有限公司总经理		